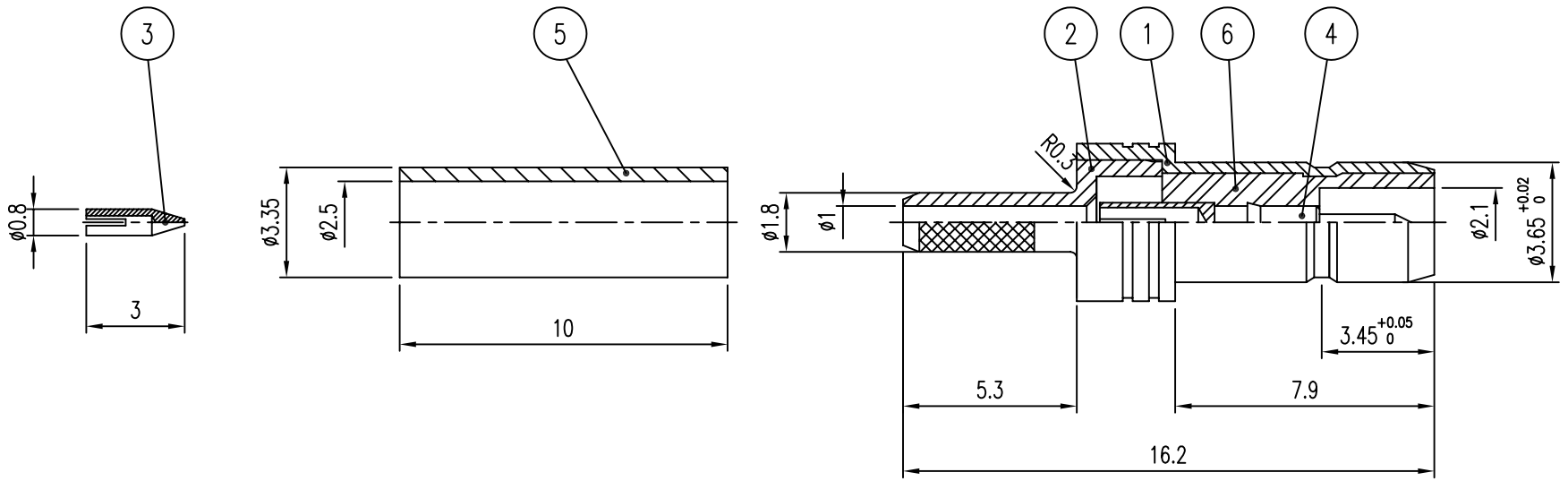
기공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	INSULATOR	1	PTFE		DIN01274-N/1
5	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00018-5/2
4	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate (0.4μm이상)	DCT01498-5/1
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00100-5/1 (E2007)
2	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate (5μm이상)	DBD01972-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate (5μm이상)	DBD01971-5/1

주 기

1. 상대물과 삽입력과 이탈력
   - 삽입력 : 2~4kgf 이하
   - 이탈력 : 5~8kgf 이상
2. 상대물 MALE외경 ø3.65~3.67이며 MAX쪽으로 관리하도록 되어있음.
3. 도금 사양

   내장용(실내)
   - Nickel Plate : 5μm 이상 (BODY,JACK,COVER)
   - Gold Plate : 0.4μm 이상 (CONTACT)

   외장용 및 수분,유해가스 접촉부
   - Gold Plate : 0.4μm 이상 (BODY,CONTACT,JACK,COVER)

대체가능재질	년월일	2008. 5. 7.	KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인		
	검도		도명 SMB-JC-178 VER.0
재질	제도		
열처리	작성부서	연 구 소	A4 도번 CN01992-7/1
보호피막처리	척도 5/1	단위 mm	중량